

公司代码:688376 公司名称:美埃科技
美埃(中国)环境科技股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告“第三节 管理讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为191,988,392.7元,截至2024年末公司可供分配利润为491,214,003.32元。公司在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下,经综合考虑后,公司拟以实施权益分派股权登记日(其具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金股利,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本134,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,880,000.00元(含税)。2024年度公司现金分红金额占归属于上市公司净利润的比例为14.00%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司简介
1、公司简介
1.1 公司股票简况
□适用 √不适用
1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式

股票简称	股票代码	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	688376	美埃科技	688376	不适用
科创板上市交易系统简称		美埃科技		不适用
上海证券交易所简称		美埃科技		不适用
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	Chin Kim Fai(陈奇祥)	邱明		
联系地址	南京市江宁区秣陵街道霞路101号	南京市江宁区秣陵街道霞路101号		
联系电话	025-52124198	025-52124198		
传真	025-52123459	025-52123459		
电子邮箱	ir@mayar.com.cn	ir@mayar.com.cn		

2、报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务、主要产品或服务情况
1. 主要业务
公司成立于2001年,二十余年以来始终聚焦于半导体、生物制药、公共医疗卫生等领域

的工业级空气净化产品的研发和应用,并将这一技术进一步转化应用于商用、民用及工业级空气净化。公司拥有丰富产品参数、品牌声誉、市场占有率领先国内厂商,对标海外知名企业。公司立足中国市场,不断向东南亚等半导体新兴产区区域布局,目前已经在9个境内生产基地和12个境外生产基地、客户覆盖国内外知名半导体龙头厂商。2021年底,公司获国家级专精特新“小巨人”称号,成为国内电子半导体洁净室设备龙头企业。2024年4月,公司获国家制造业单项冠军企业证书,冠军产品为超净型智能风机过滤器机。

2. 主要产品
公司主要产品有风机过滤器单元、过滤器(初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器、化学过滤器等)、空气净化设备、工业除油雾净化设备、VOCs治理设备等。

(1)风机过滤器单元:是洁净室空气净化器的关键设备,主要用于半导体、生物制药、新能源光伏、食品加工等行业洁净厂房及洁净室中,是空气净化器的关键设备。装于洁净室的吊钩或洁净区域的上方或侧墙,搭配内网高效超高效过滤器,提供稳定的洁净气流,通过气流的推出作用和稀释作用将室内污染物有效净化,从而达到高洁净度的要求。

(2)过滤器产品:搭配风机过滤器单元使用,用来去除空气中的杂质,应用于洁净室中特定工序、洁净室新风系统、暖通系统等。根据用途和过滤效率分为初中效过滤器、高效过滤器、静电过滤器和化学过滤器等。

(3)空气净化设备:内置搭配不同的过滤器产品进行销售。可用于生物制药(生物安全、无菌净化设备)、室内空气净化(商用、民用、家用空气净化)、餐饮环境(除油烟设备)。

(4)大气排放治理设备:公司提供系统解决方案,包括粉尘治理系统、油雾净化系统及VOCs有机废气治理系统。公司已开发出多系列的废气治理设备,如干式除尘设备、湿式除尘设备、VOCs液相转化及RCO蓄热催化氧化设备等,用于去除工业生产过程中的粉尘、油雾和有机废气等大气污染物。



来源:公司官网、国金证券研究所
2.2 主要经营模式
1. 盈利模式
公司主要从事空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产和销售。在业务开展过程中,公司以产品的研发、设计及制造为中心,结合客户的需求及应用场景为客户提供空气净化产品及服务,主要通过直销方式实现销售,实现收入和利润。

2. 采购模式
公司建立了严格的质量管理体系,制定了《供应商控制程序》《采购控制程序》等完善的供应商导入和考核规范。公司主要采用“以销定产”的采购模式。以风机过滤器单元和过滤器产品为例,公司采购的主要材料包括风机、滤材、板框、铝型材、粘合剂等物料。公司根据订单情况安排核心部件采购,非核心的辅助材料根据价格及市场供给情况定期进行备货。

3. 生产模式
(1)生产模式概述
公司产品生产主要根据订单执行,即根据客户订单要求进行产品设计和生产。公司在获得销售订单后,由销售部根据工程设计与订单情况制作生产计划单,并下达各个生产车间进行生产。生产完工后,公司可对产品进行质量检查,质检合格,公司包装安排发货。

(2)生产基地情况
报告期内,公司主要拥有9个境内生产基地及2个境外生产基地,具体情况如下:
图2:公司生产基地

生产基地	所属主体	面积(m²)	主要生产产品
南京生产基地	美埃科技	65,710.57	风机过滤器单元、初中效过滤器、高效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化设备
中山生产基地	美埃中山	6,640.00	初中效过滤器、高效过滤器
成都生产基地	美埃成都	1,914.21	初中效过滤器
天津生产基地	美埃天津	8,139.41	初中效过滤器、高效过滤器
无锡生产基地	美埃无锡	3,000.00	除尘设备、大气、环境治理产品
美埃环境生产基地	美埃环境	3,555.00	空气净化设备、排风除尘设备、新风设备、油雾净化设备、油雾净化设备
美埃电子生产基地	美埃电子	2,000.00	微静电过滤器
美埃环保生产基地	美埃环保	2,500.00	空气净化设备
南京嘉必安生产基地	美埃嘉必安	6,537.89	从事VOCs有机废气处理等环保设备的研发、生产及销售
马来西亚生产基地	美埃马来西亚	8,837.17	风机过滤器单元、初中效过滤器、高效过滤器
加拿大生产基地	Cirad-Anc Inc.	3,045.26	从事微静电空气净化设备的研发、生产及销售

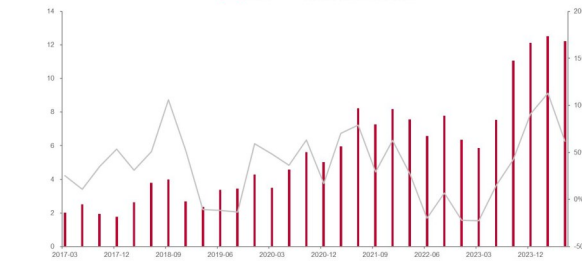
(3)外协生产(OEM)
报告期内,公司根据发展的需要,对家用/商用空气净化、油雾净化、送风等相对成熟且标准的产品采用少量OEM生产以补充产能。同时,对于工业除设备等新一代产品,由技术、市场开拓后,公司采用OEM生产方式实现新产品的快速上市,后续根据市场需要和厂房建设情况进行自产产能规划。

4. 销售模式
公司的销售模式按照获取方式可分为利用自主品牌公开竞标和客户直接下单。大型项目的客户一般采取招投标方式,公司销售人员根据相关竞标要求制作招标文件参与投标;长期合作的客户,公司一般定期签订框架协议,并根据客户的订单安排发货。
公司主要销售模式按照是否最终客户可分为直销、经销。公司直销模式为:直销模式客户主要靠净化项目自主开发或包工,主要通过自主品牌公开竞标和客户直接下单,由技术、市场开拓。经销模式客户主要靠提供样品或备件,主要通过公司销售团队推广获取订单和客户直接下单,主要采用买断式经销,占比较少。

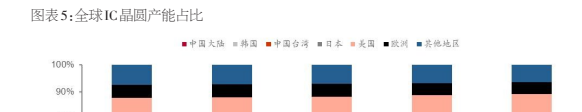
2.3 所处行业情况
(1) 行业的发展概况、基本特点、主要技术趋势
公司所处的空气净化行业,以半导体领域为例,洁净室是下游制造核心环节。洁净室是一种控制空气中微小颗粒、有害气体和微生物等污染物的特殊空间,可以在室内控制温度、湿度、压力、气流速度和方向、噪音、电磁干扰、微振动、湿度和静电等因素,以达到特定需求下所规定的洁净度等级。洁净室广泛应用于电子、半导体、生物医学、光学与航空航天等领域。

洁净室的主要原理是利用流体力学的相关性质来控制室内污染,通过内部搭载高效/超高效过滤器的风机过滤器单元,提供稳定的洁净气流,通过气流的推出作用和稀释作用将室内污染物有效净化,从而达到高洁净度的要求。
公司采用滤网、滤材、滤材和型材等上游材料,部分核心的领先材料由公司自主研发,例如PTFE滤材,由公司上游合作方联合研发,并已实现50%以上的国产替代;纳米纤维材料和改性活性炭,公司拥有独特的改性技术,比如超微孔纤维材料改性技术、分子筛技术、活性炭改性技术,属于先进纤维技术等,通过物理、改性剂改性、浸渍法控制等工艺使产品性能领先行业水平。加工制造成过滤器、风机过滤器单元和空气净化产品,其中过滤器产品既可以作为零部件用于另外两个产品的生产,也可以单独对客户进行销售。公司的核心技术是基于应用技术、材料技术、产品的深度了解和研发而形成的有竞争力的综合解决方案。公司的技术应用场景包括洁净室空气净化、室内空气品质优化、室内空气治理,其中洁净室场景的收入占比最高。

图3:公司产品产业链上下游

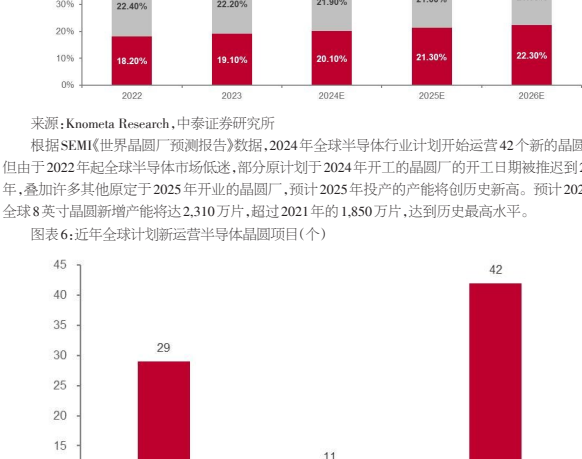


来源:iFIND、中泰证券研究所
从中长期来看,2026年中国大陆有望成为全球最大IC晶圆产能来源地。根据Knometa Research数据显示,截至2023年中国大陆月度晶圆产能占全球的份额为19.1%,落后韩国和中国台湾约3%左右。未来,中国大陆的半导体产能份额将逐步增加,预计到2025年,中国大陆的产能份额将与主要国际地区持平,预计到2026年,中国大陆IC晶圆产能份额将位居全球首位,达到22.3%。

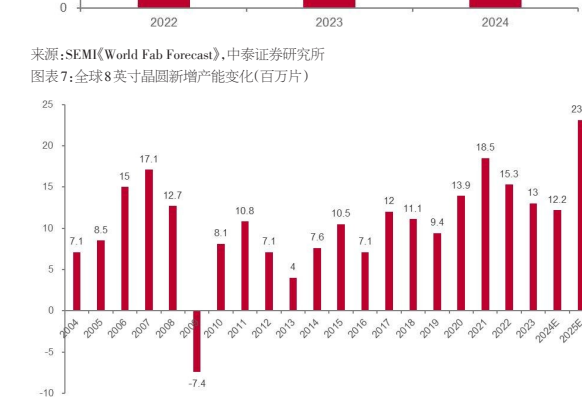


来源:Knometa Research,中泰证券研究所
根据SEMI《世界晶圆厂预测报告》数据,2024年全球半导体行业计划开始运营42个新的晶圆厂,但多于2022年起全球半导体市场低迷,部分工厂于2024年开工的晶圆厂的开工日期被推迟到2025年,叠加许多其他原定2025年开工的晶圆厂,预计2025年投产的产能将创历史新高。预计2025年全球8英寸晶圆产能增幅将达2,310万片,超过2021年的1,850万片,达到历史最高水平。

图6:近年全球计划新增运营半导体晶圆项目(个)



来源:SEMI(World Fab Forecast),中泰证券研究所
图7:全球8英寸晶圆新增产能变化(百万片)

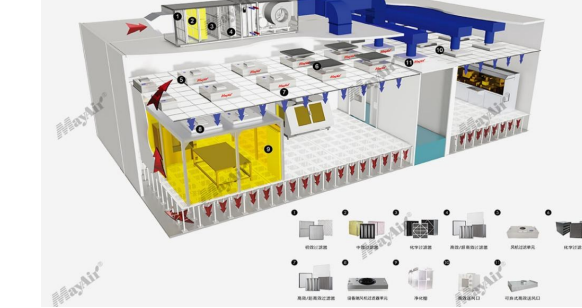


来源:Knometa Research,中泰证券研究所
对于半导体行业来说,洁净室是制造环节中重要的一环,直接影响产品良率。集成电路产业链几乎所有的关键环节,IC制造的前后道工序都需要在洁净室中完成,如果生产过程中空气净化程度达不到要求,产品良率会受到很大影响。洁净室污染物包含气态分子(AMG)和固态颗粒(particle),其中AMG包含酸性气体(MA)、碱性气体(MD)、可燃物(MC)、颗粒物(MD)及其他未分类物。相关污染物会导致硅片腐蚀、光刻胶Topping、Footing、厚胶脱落、光刻机镜片雾化、掺杂浓度波动、硅片破裂等后果,影响产量与良率。国际半导体技术路线图(ITRS)针对不同制程工艺节点所需洁净室污染物提出了明确的控制要求。一般当微粒尺寸达到IC节点一半时将对IC的制造产生影响。目前3nm的工艺已经开始研发,IC制造过程对洁净室要求越来越高,或将推动洁净室设备技术迭代,从而利用半导体洁净行业蓬勃发展。同样,洁净室设备对于显示产业的制造过程也很重要。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,698,095,987.97	2,990,488,805.36	2,408.48	2,532,125,965.58
归属于上市公司股东的净利润	1,792,424,024.05	1,633,523,977.84	24.68	1,475,250,015.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,792,863,079.21	1,505,309,979.95	14.45	1,227,061,277.74
归属于上市公司股东的净资产	191,988,392.71	173,225,679.36	10.83	123,071,519.09
归属于上市公司股东的净资产	191,988,392.71	173,225,679.36	17.48	113,248,964.82
归属于上市公司股东的净资产	-205,085,965.36	119,547,908.28	-271.55	-79,415,902.30
归属于上市公司股东的净资产	11.22	11.14	10.83	20.62
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19

图8:半导体工厂厂房的主要结构示意图



来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

未来洁净室设施市场的发展方向将有大趋势:
1)行业集中度上升。下游领域对洁净等级的持续提升,推动洁净室设施的供应商不断进行产品迭代。无法保证产品和服务质量的供应商将被市场逐步淘汰,行业的集中度进一步提升。
2)业务模式向整体解决方案转变。洁净室设施供应商逐步开展洁净室设计业务,从设备供应商进行纵向业务开拓,为客户提供整体解决方案。既保证了洁净室项目的稳定性和效率,也是供应商提供增值服务的机会。
3)洁净室技术跟需求端持续迭代。半导体芯片的制程随着摩尔定律提升,从14nm到5nm,目前正在研发突破3nm制程工艺。制程的提升对于晶圆厂的洁净度要求升级,需要更高等级的洁净度以保证制程的正常生产以及良率。因此,洁净室设施供应商需要持续投入研发,推动产品迭代。
4)中美摩擦下,东南亚各国在半导体产业链中重要性持续提升。受国际地缘格局和产业环境变化影响,半导体产业正迁移至东南亚地区的趋势愈发明显,各行业巨头在纷纷在东南亚地区布局,东南亚在芯片行业的全球分工中重要性愈发明显。

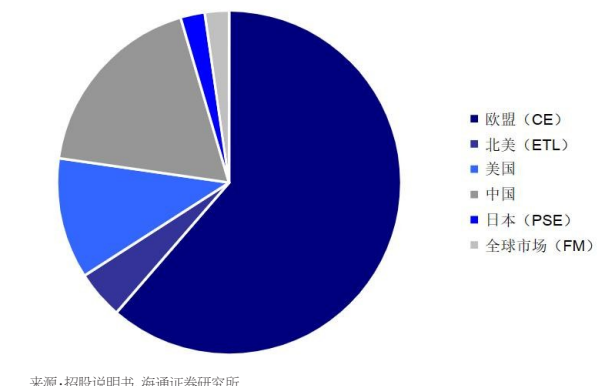
根据国际半导体产业协会(SEMI)发布《季度300mm晶圆厂展望报告》,预计2025年全球晶圆厂用于前道设施的设备支出将首次超1,000亿美元。SEMI表示,2025年全球(300mm)12英寸晶圆厂设备投资将增长20%至1,165亿美元,2026年将增长12%至1,305亿美元,到2027年将继续增长5%,达到1,370亿美元。在存储领域设备的复苏和对高性能计算(HPC)和汽车应用的强劲需求持续驱动投资加速。

中国大陆未来半导体设备资本开支有望保持全球第一。从各个国家和地区来看,中国大陆地区未来四年内每年的支出达到了300亿美元,引领全球设备市场;中国台湾地区排在第二,将从2024年的263亿美元增至2027年的280亿美元;韩国则排在第三,从2024年的195亿美元增至2027年的263亿美元;美洲地区从2024年的120亿美元增至2027年的247亿美元;日本、欧洲和中东,以及东南亚地区到2027年,分别达到114亿美元、112亿美元和53亿美元。

半导体行业由东南亚转移,多个国际半导体巨头布局马来西亚。受国际地缘格局和产业环境变化影响,半导体产业正迁移至东南亚地区的趋势愈发明显,东南亚在全球芯片测试市场份额已达27%,其中马来西亚的占比一半。马来西亚吸引了多个国际半导体巨头布局。根据马来西亚半导体行业协会(MSIA)的统计,马来西亚已成为第六大半导体出口国,其半导体占全球贸易总额的7%,净贸易顺则达13%。

目前公司在积极开拓海外市场,公司产品国内外认证体系完善,“出海”前期工作准备充分。海外产品在近两年半以上的认证周期,公司在前期市场开拓阶段通过获取海外认证体系,主要产品目前均已获得FM,UL,AHAM,CE,ROHS,CCC等认证证书,为“出海”打下基础。

图10:公司产品国内外认证体系完善



来源:招股说明书、海通证券研究所
国外产能方面,公司在马来西亚当地的产能约为1.5亿人民币。海外市场增速较快,客户主要分布在东南亚,其次,欧洲和中东等地区的销售业务也在持续增长。公司加速布局东南亚等海外市场,进入核心国际客户供应链,目前已经通过了多个国际著名厂商的合格供应商认证,如半导体芯片厂商、新能源厂商、光伏、商、空调厂商等并已开展商业实质业务。著名厂商的认证有望为公司带来海外发展的便利,有助于公司加速进入其他国际著名厂商的全球业务。

(3) 报告期内,新技术、新产业、新业态、新模式的实施情况和未来发展趋势
(1)新技术、新产业、新业态、新模式
人工智能技术的革命性突破深刻重塑半导体与芯片行业格局,作为实现人工智能的核心技术之一,半导体制造业在AI及AI相关芯片技术领域的突破,既为其带来驱动性机遇,也构成前所未有的挑战。

AI技术的迅猛发展催生了算力需求的指数级增长,大模型训练对算力的需求每3-4个月翻倍,远超摩尔定律的演进速度,推动高算力计算芯片(如GPU/TPU/ASIC)市场持续扩张。预计到2030年,AI芯片市场规模将突破2,000亿美元,与此同时,AI驱动的边缘计算与终端智能化革命(如自动驾驶、智能家居及工业物联网)催生对大量算力芯片需求,促使边缘化芯片设计领域蓬勃发展。此类新兴市场机遇将驱动芯片产业向边缘化与终端化方向演进,其深远影响或远超当前想象。

然而,行业亦面临多重挑战:半导体芯片技术已逼近物理极限,例如硅基芯片1nm以下制程需应对量子隧穿效应;EUV光源机台成本超1.5亿欧元,3nm工艺研发投入超200亿美元;AI训练的高能耗导致碳排放加剧,难以满足全球碳中和目标,且散热需求加剧了热管理难题。此外,地缘政治格局加剧了供应链风险,例如美国《芯片法案》限制14nm以下设备对华出口,而中国则加速成熟制程(28nm)产能占比提升50%以上作为应对策略。先进制程核心设备的高投入(如ASML EUV光源机台产能仅40套)以及光刻胶等关键材料的市场垄断(日本占全球90%份额),亦成为行业发展的关键制约因素。

展望未来,绿色半导体与区域化供应链将成为主要趋势。欧盟《芯片法案》要求至2030年芯片产能翻倍50%,并提升绿色芯片产能比例;美国计划于2024年实现本土芯片产量占全球30%,中国大陆则计划扩大28nm以下成熟制程布局。AI技术革命将推动半导体行业进入“超摩尔定律”时代,技术突破与供应链韧性(多区域产能布局)将成为核心竞争力,以应对地缘、成本与地缘政治的多重挑战。

在新能源产业端,中国正逐步成为全球关键参与者。预计2025年中国新能源汽车销量将接近1,500万-1,600万辆,渗透率首次超越燃油车(约51%),其中插电混动与增程式车型占比显著提升,增速或达60%。动力电池需求同步增长,固态电池技术加速产业化,2025年固态电池出货量预计接近100Wh,全国企业有望在未来3-5年实现小规模量产。光伏与风电装机量呈现分化态势,光伏增速或放缓至25%以下,而风电新增装机量有望保持12%增长,海上风电占比持续提升。

(供AI技术赋能,新能源汽车加速“智能移动终端”转型,预计12级自动驾驶渗透率达65%,13级自动驾驶有望10年内实现量产。技术革新将进一步聚焦高压快充、固态电池及BC光伏电池等领域,推动行业从“规模扩张”向“质量升级”转型。
对于贸易壁垒,中国在全球化布局持续深化。欧盟加征关税等措施倒逼企业调整出海策略,转向“贸易+投资”模式,重点开拓东南亚、中东及拉美等新兴市场。预计2025年新能源汽车出口量将达140万辆,本地化生产与合资模式成为主流。

(2) 未来发展趋势
1) 半导体产业链国产化替代进程持续加速
尽管国际格局不确定性加剧,但美国对华高科技领域打压态势将长期存在。半导体设备国产化将快速推进,一方面需突破先进制程技术以实现自主替代,另一方面需依托新能源产业全球化布局,推动具备竞争力的产品出海,并带动配套“国产化”产业链业务协同发展,高效、节能、智能的洁净室技术、产品与服务将成为竞争关键。

2) 数字化与智能化成为产业升级核心方向
半导体行业正加速向智能化、数字化与绿色化方向演进。国内企业通过技术突破与全球化布局逐步打破海外垄断,同时新兴企业(如智能能源、跨行业融合)与商业模式(服务型制造、按需定制)进一步驱动产业升级。未来,随着半导体制程微细化与环保政策趋严,高效、节能、智能的洁净室技术、产品与服务将成为竞争关键。

3) AI技术赋能催生多元产业发展机遇
AI算力需求、芯片产能及数据技术的需求,以及其与各行业的深度融合,将作为产业化领域创造广阔机遇。数据计算、芯片产能制造升级、AI高能耗与碳中和目标的矛盾等挑战,均催生产业发展需求。此外,随着2030年前,ESG关注度持续提升,构建绿色足迹核算标准、研发节能环保材料、搭建数字化碳足迹与交易平台,将成为行业共识。

4) 产业链一体化协同模式成为发展壁垒
在技术需求与市场细分化背景下,企业核心技术及解决方案的专业性要求日益提升。空气净化设备为跨学科交叉技术,需立足核心产品研发,向上拓展多元材料开发,向下延伸诸多专业应用解决方案,逐步构建“设备+材料+产品+系统+一站式测试”的完整产业链闭环,通过全产业链布局增强技术自主性,全面提升市场竞争力。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

2024年	2023年	2022年	2021年	2020年
营业收入	3,698,095,987.97	2,990,488,805.36	2,408.48	2,532,125,965.58
归属于上市公司股东的净利润	1,792,424,024.05	1,633,523,977.84	24.68	1,475,250,015.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,792,863,079.21	1,505,309,979.95	14.45	1,227,061,277.74
归属于上市公司股东的净资产	191,988,392.71	173,225,679.36	10.83	123,071,519.09
归属于上市公司股东的净资产	191,988,392.71	173,225,679.36	17.48	113,248,964.82
归属于上市公司股东的净资产	-205,085,965.36	119,547,908.28	-271.55	-79,415,902.30
归属于上市公司股东的净资产	11.22	11.14	10.83	20.62
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19
归属于上市公司股东的净资产	1.45	1.29	10.83	1.19

图8:半导体工厂厂房的主要结构示意图

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

图9:海外竞争对手

来源:华经产业研究所
近年来,半导体领域供应链的安全处于极为重要的位置,半导体行业受到前所未有的政策支持,高科技企业尤其是半导体领域企业的国产替代进程快速推进,国内的晶圆代工、IDM厂商以及封测厂商纷纷加大投入,建设新的晶圆厂,风机过滤器单元、超净型油雾净化设备需求持续增长。

中国晶圆制造产能仍处于快速扩张期,从产业链配套层面来看,在中游晶圆制造环节,中国具备成为全球晶圆制造产能核心基地的潜力。

SEMI报告指出,2024年下半年,生成式AI和高能效运算(HPC)等应用的推动,以及芯片在终端需求的复苏,成为先进制程和晶圆代工产能加速扩增的原因。近年来随着芯片行业、晶圆制造行业、生物制药行业及食品行业的产业升级,产品更新换代、大量企业新标准标准的建设,而空气净化设备市场空间与室内空气质量情况息息相关,在国内持续加强空气质量优化的相关政策支持下,空气过滤器行业市场规模迅速增加。

美埃(中国)环境科技股份有限公司
2024年年度报告摘要

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告“第三节 管理讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素,敬请投资者注意投资风险。
3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为191,988,392.7元,截至2024年末公司可供分配利润为491,214,003.32元。公司在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下,经综合考虑后,公司拟以实施权益分派股权登记日(其具体日期将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东派发现金股利,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本134,400,000股,以此计算合计拟派发现金红利26,880,000.00元(含税)。2024年度公司现金分红金额占归属于上市公司净利润的比例为14.00%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司简介
1、公司简介
1.1 公司股票简况
□适用 √不适用
1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--